



产品规格书/Specification

产品/product:	填孔铜浆/ Through hole Cu paste
料号/Part number:	25H-5901

适用范围/Application:

此产品适用于 LTCC,LED 等陶瓷电路填孔使用。

Suitable for LTCC、LED etc, Ceramic circuit through hole.

使用条件/Operating conditions:

基材 Substrate	陶瓷电路 Ceramic circuit
印刷 Printing	丝网印刷 Screen printing
流平 Levelling	5-15min minutes at room temperature 室温下流平 5-15 分钟（时间根据流平的实际情况决定）。
干燥 Drying	通风烘箱烘烤 100-150℃，10-15 分钟 （干燥温度低于 300℃，可根据烘烤的实际情况决定烘烤时间。） 100-150℃ 10-15 min
烧结 Firing Condition	隧道炉氮气保护气氛下烧结，峰值 830±10℃（推荐值），10-20 分钟。 （可根据实际需要，烧结范围可在 800-850℃内调节,但峰值温度时间必须至少 10 分钟。）
Thinner	ST-1000

性能/Characteristics:

1. 浆料性能/Paste Characteristics:

性能 Characteristic	标准 Standard	测试方法及条件 Test method and conditions
1 Fineness	≤5μm	FOG test
2 Viscosity	200-580Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃, Brookfield HBT (博利飞) 粘度计, 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃ 粘度可根据用户实际需要调节。

2. 烧结后特性/Characteristics after firing:

在 1 烧结条件下, 膜厚 8-12μm Check fired film produced under the conditions specified in 1), (Film thickness is 8-12μm.)



深圳市賽雅電子漿料有限公司
Shenzhen Sryeo Electronic Paste Co., Ltd.

Tel: 0755-28078692 Fax: 0755-28078687

www.sryeo.com(中文) www.sryeo.net (Eng.) sales@sryeo.com

特性 Characteristics	Standard 标准	测试方法和条件 Test method and conditions
3 Resistivity 方阻	$\leq 20\text{m}\Omega/\square$	Test pattern 0.6mm×60mm 测试图形 0.6mm×60mm

保存条件，有效期/Storage condition and Term of validity

产品应在 5-25℃ 的环境温度下密封储存，有效期为产品发货之日起 1 年。

The product shall be guaranteed for 1 year after shipping date, keep tightly under at 5-25℃

包装方式/Packaging method:

标准包装，1000g/罐，样品可提供 200 克小罐包装

Standard package 1000g/can, if you need sample to test, available 200g with small package.